

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录汇总表

(2024年7月10日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	国泰基金 李阜阳、远望角投资 虞光、中信证券 郑凯航、华创资管 孙元、同泰基金 麦健沛、时代伯乐 邓澄江、山西证券 田发祥、山西证券 沈雨焦	
会议时间	2024年7月10日 13:30-14:30、15:00-16:00	
会议地点	佰维存储三楼会议室	
上市公司接待人员姓名	公司管理层、董办工作人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1. 固件算法对存储产品性能、稳定性和安全性影响较大，公司是否有布局自研固件算法？</b>                      A1: 公司掌握了接口协议、FTL 核心管理算法、QoS 算法、数据保护、数据安全等核心固件算法，全面掌握了存储固件核心技术，有能力匹配各类客户典型应用场景，并能够为客户提供创新优质的存储解决方案。同时，公司有能力和能力结合算法需要定义主控芯片架构，以提升算法效率和实现基于应用场景的硬件加速及效能优化，进一步提升产品在智能穿戴、企业级、工车规级等场景下的竞争优势。</p> <p><b>Q2. CXL 旨在解决高性能计算中的瓶颈问题，公司在 CXL 方面有什么前瞻布局？</b>                      A2: CXL 内存扩展功能可在服务器中的直连 DIMM 插槽之外实现额外的内存容量和带宽，支持内存池化和共享，满足高性能 CPU/GPU 的算力需求。公司发布的 CXL2.0 DRAM 采用 EDSFF (E3.S) 外形规格，内存容量高达 96GB，同时支持 PCIe5.0×8 接口，理论带宽高达 32GB/s，可与支持 CXL 规范及 E3.S 接口的背板和服务器主板直连，扩展服务器内存容量和带宽。CXL 是新一代的互联技术，在 AI 和服务器领域有广泛的前景，公司将持续关注 CXL 技术。</p> <p><b>Q3. 公司目前已通过认证的 SoC 芯片及系统平台有哪些？</b>                      A3: 公司主要产品已进入高通、Google、英特尔、微软、联发科、展锐、晶晨、全志、瑞芯微、瑞昱、君正等主流 SoC 芯片及系统平台厂商的合格供应商名录。</p> <p><b>Q4. 公司在 TO-C 端市场业务进展情况如何？</b>                      A4: 在 C 端市场，公司双向发力，一方面运营公司自主品牌佰维 (Biwin)，主要在京东、抖音等线上零售平台销售，以及通过与代理商合作开发线下渠道市</p>	

	<p>场；另一方面独家运营的惠普（HP）、宏碁（Acer）、掠夺者（Predator）等授权品牌，主要在京东、亚马逊等线上平台，以及 BestBuy、Staples 等线下渠道开发 PC 后装、电子竞技等 ToC 市场，并取得了良好的市场表现。</p> <p><b>Q5. 高品质 LPDDR 有高频率、大容量、低功耗等要求，公司如何强化 LPDDR 产品的测试能力？</b></p> <p>A5：公司在 2022 年引进全球领先的 Advantest（爱德万）T5503HS2 量产测试系统，与公司自研的全自动化测试设备相结合，进一步强化了公司全栈存储芯片测试能力，结合丰富的自研测试算法库，可以对 DDR5/LPDDR5X 等高端芯片进行全面的特性分析，保证产品品质，并达到客户要求的高性能指标。</p> <p><b>Q6. 上游晶圆的供应稳定对存储解决方案厂商很重要，公司在保障晶圆供应方面有哪些措施？</b></p> <p>A6：通过多年的合作，公司已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系，通过与主要的存储晶圆原厂签订 LTA（长期供应协议）合作，可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。</p> <p><b>Q7. 半导体存储产业链下游应用场景丰富，针对不同终端领域，公司如何把握行业机遇？</b></p> <p>A7：公司把握行业上行机遇，在手机、PC、服务器等领域着力扩大客户覆盖面，做大营收，力争突破一线客户；在智能穿戴和工车规领域投入战略性资源，力争成为市场的主要参与者。公司将持续深化研发封测一体化布局，重点加强芯片设计、先进封测和测试设备能力构建，矢志成为全球存储与先进封测行业的创新者。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 7 月 10 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。